

preliminary

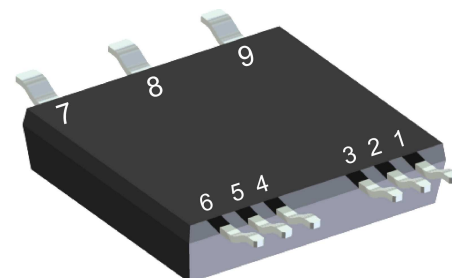
Sonic Fast Recovery Diode

V_{RRM}	=	1200 V
I_{DAV}	=	34 A
t_{rr}	=	150 ns

High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 1~ Rectifier Bridge

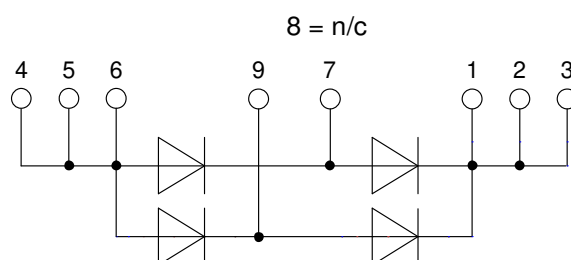
Part number

DHG40B1200LB



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: SMPD

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry convenient outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

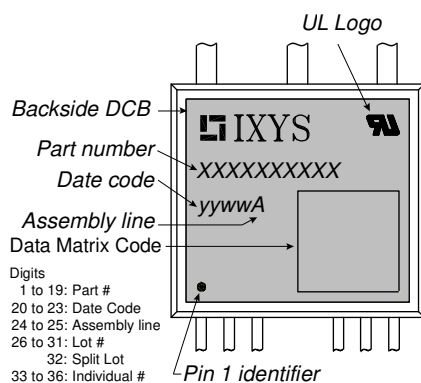
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Fast Diode				Ratings				
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit	
V _{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				1200	V	
V _{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				1200	V	
I _R	reverse current, drain current	V _R = 1200 V	T _{VJ} = 25°C			40	μA	
		V _R = 1200 V	T _{VJ} = 125°C			0.4	mA	
V _F	forward voltage drop	I _F = 20 A	T _{VJ} = 25°C			2.24	V	
		I _F = 40 A				2.89	V	
		I _F = 20 A	T _{VJ} = 125°C			2.24	V	
		I _F = 40 A				3.15	V	
I _{DAV}	bridge output current	T _C = 80°C rectangular d = 0.5	T _{VJ} = 150°C			34	A	
V _{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		T _{VJ} = 150°C		1.35	V	
r _F	slope resistance					43	mΩ	
R _{thJC}	thermal resistance junction to case					1.5	K/W	
R _{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.50		K/W	
P _{tot}	total power dissipation	T _C = 25°C				80	W	
I _{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine; V _R = 0 V		T _{VJ} = 45°C		150	A	
C _J	junction capacitance	V _R = 600 V f = 1 MHz		T _{VJ} = 25°C	8		pF	
I _{RM}	max. reverse recovery current	} I _F = 15 A; V _R = 600 V -di _F /dt = 600 A/μs		T _{VJ} = 25 °C	15		A	
				T _{VJ} = 125 °C	20		A	
t _{rr}	reverse recovery time			T _{VJ} = 25 °C	150		ns	
				T _{VJ} = 125 °C	250		ns	

preliminary

Package SMPD			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			100	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		150	°C
T_{op}	operation temperature		-55		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				8.5		g
F_c	mounting force with clip		40		130	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	1.6			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	4.0			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3000			V
		t = 1 minute	2500			V



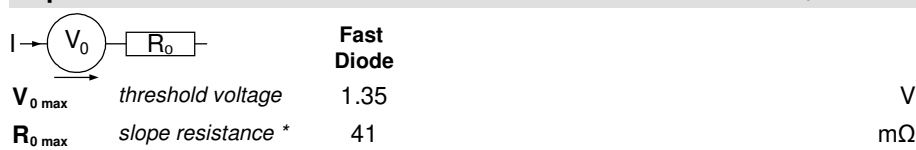
Part description

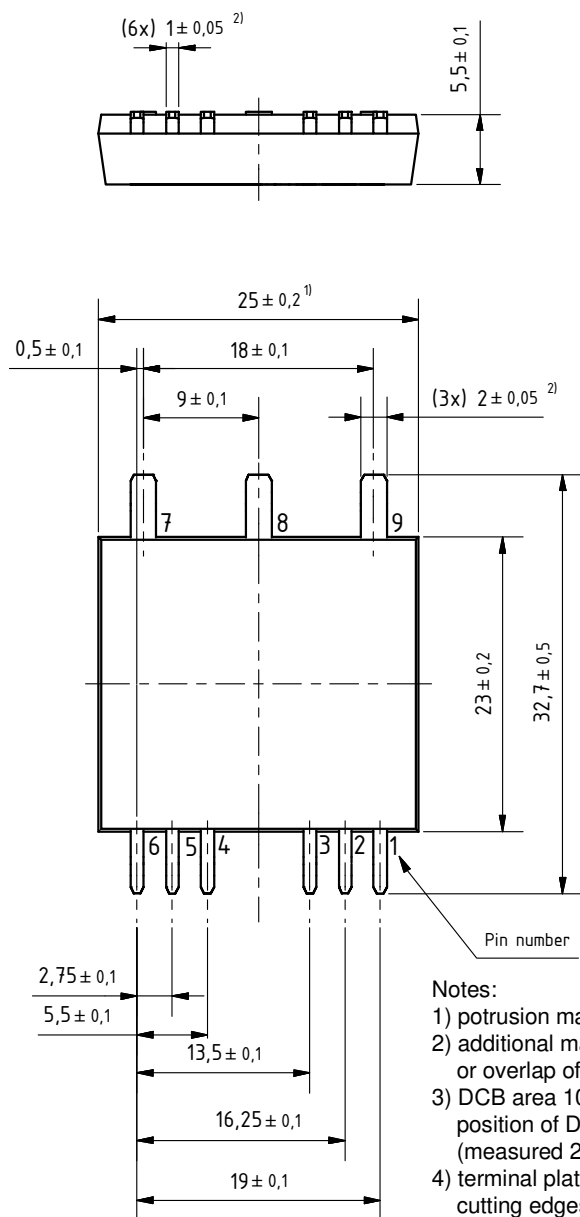
D = Diode
 H = Sonic Fast Recovery Diode
 G = extreme fast
 40 = Current Rating [A]
 B = 1~ Rectifier Bridge
 1200 = Reverse Voltage [V]
 LB = SMPD-B

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DHG40B1200LB-TUB	DHG40B1200LB-TUB	Tube	20	525198
Alternative	DHG40B1200LB-TRR	DHG40B1200LB	Tape & Reel	200	524922

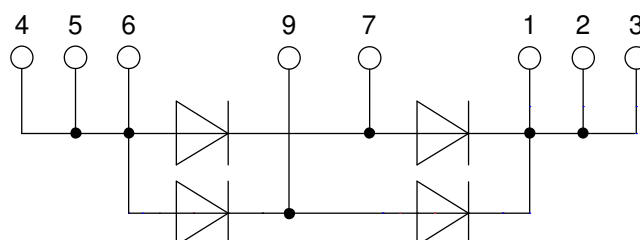
Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

 $T_{VJ} = 150\text{ °C}$


Outlines SMPD
A (8 : 1)

Notes:

- 1) protrusion may add 0.2 mm max. on each side
- 2) additional max. 0.05 mm per side by punching misalignment or overlap of dam bar or bending compression
- 3) DCB area 10 to 50 μm convex; position of DCB area in relation to plastic rim: $\pm 25 \mu\text{m}$ (measured 2 mm from Cu rim)
- 4) terminal plating: 0.2 - 1 μm Ni + 10 - 25 μm Sn (gal v.) cutting edges may be partially free of plating

8 = n/c


Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9